

重庆臻宝科技股份有限公司

关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 超额募集资金金额及使用用途

重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“臻宝科技”）全资子公司武汉臻宝半导体科技有限公司（以下简称“武汉臻宝”）拟使用超募资金人民币25,000万元投资新建“半导体零部件研发生产基地项目”。

- 公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

- 相关风险提示：本项目实施过程中可能存在宏观政策、市场环境、团队建设、项目进度等方面的不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

一、募集资金基本情况

发行名称	首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市
募集资金总额	172,993.51万元
募集资金净额	160,477.08万元
超募资金金额	40,724.78万元
募集资金到账时间	2026年6月18日

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、超募资金使用安排

超募资金金额	40,724.78万元
前次已使用金额	0万元
本次使用用途及金额	☑新项目，半导体零部件研发生产基地项目，项目投资总额52,000万元，其中拟使用超募资金投入金额为25,000万元

1、项目基本情况

新建项目名称	半导体零部件研发生产基地项目
实施主体	武汉臻宝半导体科技有限公司 (臻宝科技全资子公司)
实施地点	武汉东湖新技术开发区
项目内容	本项目将围绕碳化硅原材料和零部件、高纯硅精密零部件、氮化铝陶瓷材料和零部件几大核心方向进行建设。
项目总投资金额	52,000.00万元
投资建设周期	3年

2、项目必要性分析

(1) 保障国内半导体产业链供应链安全，落实国家自主可控战略

当前，集成电路产业先进制程非金属核心零部件本土供给能力仍不足，部分高精密耗材、功能性陶瓷零部件仍依赖境外厂商供给。受外部环境持续收紧影响，海外厂商在设备维保、零部件供货、技术服务等方面存在显著的不确定性，供应链中断风险直接威胁国内先进制程产线的稳定量产。

随着国内头部晶圆制造基地产能持续扩容，产线对高精密零部件耗材的需求量同步激增，必须同步培育规模化本土零部件配套产能，以强化国内供应链纵深，降低对境外来源供给的依赖。本次通过武汉臻宝新建“半导体零部件研发生产基地项目”可大幅提升高精密零部件本土供给规模，有效填充高端耗材零部件产能缺口，是构建安全可控的集成电路供应链体系的必要产业配套布局。

(2) 匹配核心客户产能扩张节奏，破解公司现有产能瓶颈

未来几年，国内主要晶圆制造企业的先进工艺产线将持续扩产，分批次落地大容量新建晶圆产线，叠加存量产线工艺升级改造需求，一方面带来新增设备配套耗材增量，另一方面存量产线持续产生耗材替换需求，形成“增量+存量”的双重市场空间，零部件年度采购需求同比大幅增长。

公司现有生产基地已达设计产能上限，长期处于满产甚至超负荷运行状态，新增配套订单无法完全承接，存在订单延期交付、市场份额流失、错失本轮扩产景气周期的经营风险。本次通过武汉臻宝新建“半导体零部件研发生产基地项目”，可快速释放规模化产能，足额匹配客户中长期耗材采购增量，巩固公司在核心零部件细分赛道的头部地位。

（3）缩短配套服务半径，深度绑定客户

原有生产基地与武汉晶圆制造集群存在跨区域物流成本偏高、客户响应效率不足等短板，样品送样、技术支持等环节周期较长。武汉子公司近距离配套下游核心制造客户产线，可大幅缩短样品交付、技术支持及验证周期；同时削减长途运输成本，规模生产后可有效摊薄单位制造成本，提升产品综合竞争力。

就近配套还可深度参与客户新工艺前置研发，高效响应客户工艺迭代中的定制化需求，同步迭代零部件产品方案，从而加深上下游协同绑定，构筑区位配套壁垒，实现从产品供应向技术协同的关系升级。

3、项目可行性分析

（1）政策与产业区位可行性

本项目落地武汉半导体产业集聚片区，契合国家集成电路关键零部件自主可控顶层规划方向，匹配湖北省、武汉市针对半导体产业发展的专项扶持政策。国内先进制程芯片制造基地持续加码产能扩建，本土晶圆制造端对精密腔体、硅/石英/碳化硅/陶瓷零部件、真空气控零部件的需求持续放大。武汉本地已形成较为完整的晶圆制造、设备整机、配套材料产业集群，区域可提供洁净厂房配套、专业人才支撑、上下游协同等多维营商环境支持，产业协同、生产要素配套、物流交通条件成熟，具备建厂落地的硬性政策与区位优势。

臻宝科技深耕集成电路设备核心零部件多年，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积等前道工艺专用硬脆材料零部件，已完成国内主流晶圆制造企业多轮工艺验证及批量供货，技术路线与下游产线工艺高度匹配，不存在跨工艺适配壁垒。公司产品已批量应用于先进逻辑工艺、3D NAND闪存及DRAM先进工艺存储芯片制造等领域。本次通过全资子公司武汉臻宝，贴近核心制造客户布局生产基地，落地可行性充分。

（2）市场与客户落地可行性

国内头部晶圆制造基地正分阶段释放大容量新增晶圆产能，现有零部件厂商交付缺口持续扩大，客户端具备本土供应商同步扩产配套起其产能增长的诉求，具备稳定、长期订单底盘支撑。现阶段公司现有生产基地产能已满载，订单排产周期拉长，承接客户新增扩产配套需求存在瓶颈，供需缺口形成明确的市场增量空间。

本项目产品聚焦先进制程产线高损耗核心零部件，耗材类核心部件需求具备持续性、重复性；下游客户同步推进多工艺节点迭代，对高精度、高耐蚀定制化零部件增量需求持续释放。本项目建成后可辐射湖北当地及周边客户，缩短物流周期、快速响应客户工艺调试、样品迭代的需求，大幅提升客户粘性与份额拓展能力。项目依托存量成熟认证客户资源，无需从零开展客户导入，市场转化周期短，订单消化具备较高的确定性。

（3）技术与运营实施可行性

技术层面，公司已搭建覆盖原材料制造、精密加工及高性能表面处理全流程工艺体系，拥有核心专利及工艺标准库，核心研发、工艺、品控团队可有力支撑武汉臻宝产线搭建。半导体零部件生产工艺对产品一致性要求极高，公司在新产线良率爬坡方面已积累成熟经验可迁移，不存在核心技术卡壳的风险。

运营层面，武汉产业园区配套洁净车间、化学品、电子级气体、特种废气处理、危废处置等半导体专用基础设施，要素保障较强；本地具备材料制备、精密加工及刻蚀处理等领域的产业工人供给，便于搭建本地化生产团队；并且母公司可统一实施供应链采购、研发赋能、客户协同管理，异地子公司运营管控体系成熟，可有效保障快速量产交付。

4、项目投资概算

本项目计划投资总额为52,000万元，其中拟使用超募资金投入金额25,000万元，资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用超募资金金额	投资占比
1	工程建设费用	46,017.60	25,000.00	88.50%
1.1	土地购置费	1,236.60	0.00	2.38%
1.2	场地建造及装修费	9,146.00	9,146.00	17.59%
1.3	工程建造其他费用	595.00	595.00	1.14%
1.4	硬件购置费	35,040.00	15,259.00	67.38%
2	研发费用	3,832.93	0.00	7.37%
3	基本预备费2%	997.02	0.00	1.92%
4	铺底流动资金	1,152.45	0.00	2.22%
合计		52,000.00	25,000.00	100.00%

本项目投资建设期为3年，拟利用公司已有的产业化成果、技术优势和成熟经验，促进本项目的高效实施。项目建成后将有效突破公司现有产能瓶颈，加强湖北及周边地区核心客户的产能配套与高效协同响应能力，进一步缩短交付周期、提升服务品质。本项目契合公司以客户为中心的战略定位，有助于巩固公司在核心零部件细分领域的市场地位，提升公司整体核心竞争力。

5、项目主要风险分析

(1) 技术与客户验证风险

半导体核心零部件验证周期长达数月至数年，新建产线所生产零部件需重新导入客户验证，若新建产线产品一致性表现、性能参数、耐蚀性能未达客户严苛工艺标准，将无法批量导入，导致新建产能闲置进而压缩盈利空间。

(2) 项目进程及效益不达预期的风险

公司现有产能长期处于满负荷运行状态，扩产是应对订单增长的必然选择，但产能快速扩张也伴随一定的经营压力。若新建产能无法在预期时间内实现满产，新增的人力成本、设备折旧及厂房运维费用将对企业阶段性财务表现形成压力。敬请广大投资者关注市场增速或客户扩产节奏不及预期导致产能闲置的风险。

（3）项目备案、审批风险

本项目实施需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止甚至终止的风险。

6、保障超募资金安全的措施

本项目相关审批程序履行完成后，公司将开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金，并与保荐人和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，公司将根据新建项目的实施进度，逐步投入募集资金并对项目实施单独建账核算。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用和管理募集资金，并严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、适用的审议程序及保荐人意见

（一）履行的审议程序

公司于2026年8月6日召开了第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。独立董事专门会议认为公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，有利于提高超募资金使用效率，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此外，公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。

综上，保荐人对公司使用部分超募资金投资建设新项目事宜无异议。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月8日